

第51回レーザー熱加工研究会論文集

(理研シンポジウム：レーザーによる精密微細加工)

Proceedings of 51th Laser Materials Processing Conference
(RIKEN Symposium)

目次

1. 産業応用

最近の kW 級高出力半導体レーザーの開発と適用 丸文:武田 晋 林 祐治	1
高出力エキシマレーザーとそれを利用した多点一括マイクロ加工 コマツ研究本部中央研究所:壇澤 紀之、庭月野 義行、棧敷 一明、榆 孝	10
高出力 LD 励起 YAG レーザー加工機 日本電気:石田 寿則、向原 克治、森田 浩之、常包 正樹、正子 敦司、 宮崎 昌洋	16
希ガス雰囲気パルスレーザーアブレーション法によるシリコンナノ粒子の作製と光学特性 松下電器産業:牧野 俊晴、山田 由佳、鈴木 信靖、吉田 岳人 筑波大学:大成 誠之助	21

2. 短波長・短パルスレーザープロセッシング (1)

極短パルス vs. 極短波長レーザープロセッシング 理化学研究所:杉岡 幸次	28
フェムト秒レーザーによる生体の 3 次元加工 大阪大学:中村 収	38

3. 短波長・短パルスレーザープロセッシング (2)

超短パルスレーザーによるシリコンの精密微細加工 大阪大学:村井 誠 佐野 智一、宮本 勇	44
極短波長レーザーによる GaN のマイクロプロセッシング 理化学研究所:茜 俊光、杉岡 幸次、半村 清孝、青柳 克信、緑川 克美 東京理科大学:小幡 孝太郎、青木 尚子、豊田 浩一 筑波大学:野村 晋太郎	49
短波長レーザーの新展開と光学素子加工への応用 革新的レーザーと加工応用を目指して 大阪大学:實野 孝久	59

